

SJ038015
('ON 0NIMVHD) 台要図図

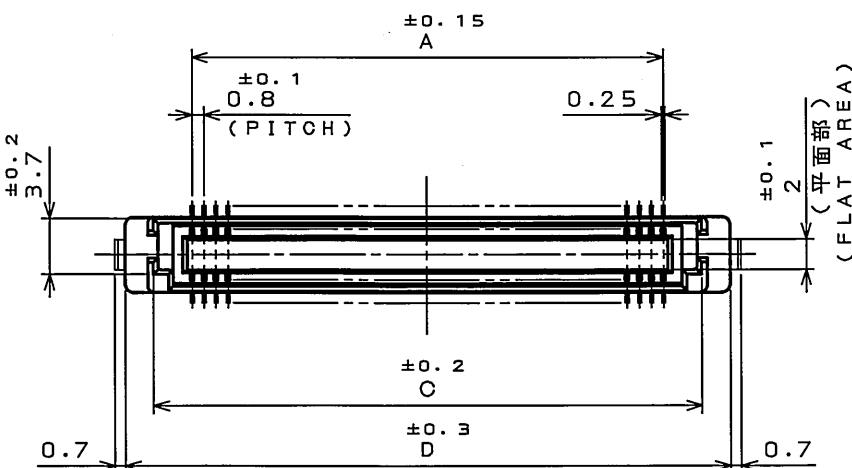
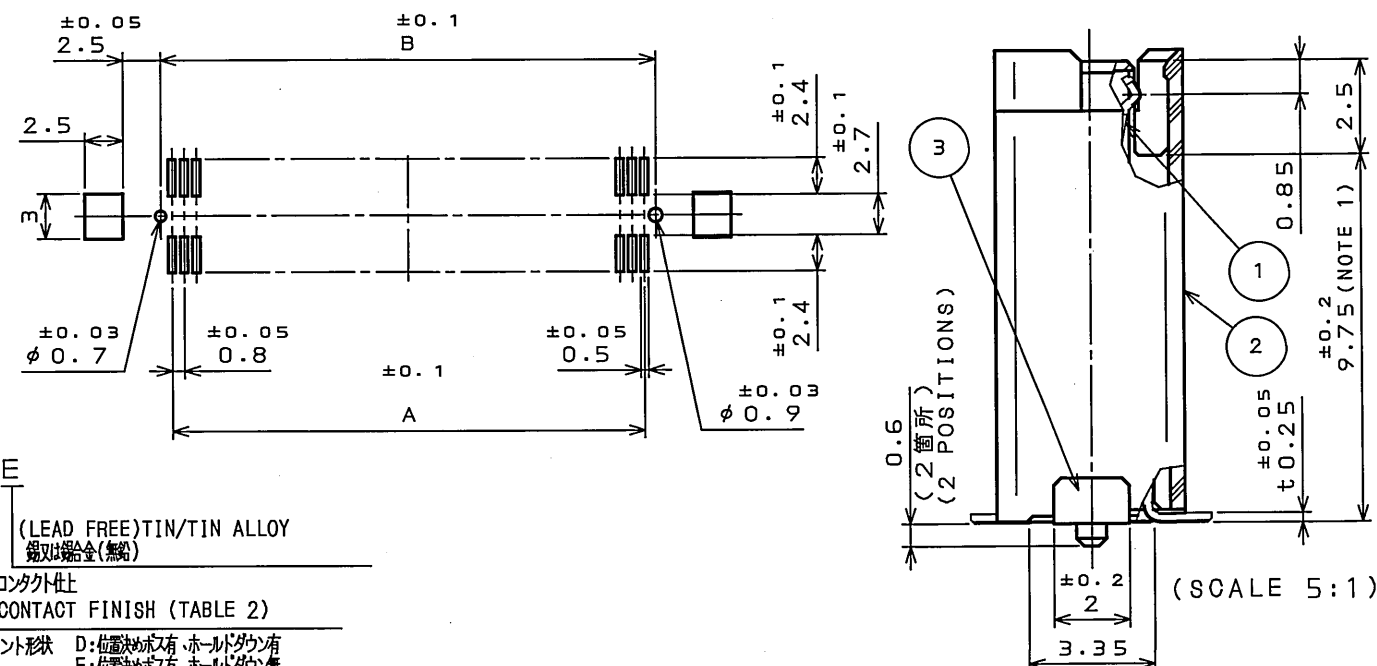


TABLE 2 CONTACT FINISH

仕上記号 FINISH	接触部仕上 CONTACT AREA	端子部仕上 TERMINAL AREA
無印 NONE	NI上Au0.1μm以上 GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	NI上Auフラッシュ GOLD FLASH OVER NICKEL
1	NI上Au0.1μm以上 GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL	錫または錫合金(無鉛) (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
2	NI上Au0.3μm以上 GOLD (0.3μm MIN) OVER NICKEL	NI上Auフラッシュ GOLD FLASH OVER NICKEL

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法(参考)



DESIGNATION

命名法

KX14-**-K11D**E

(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

コンタクト仕上
CONTACT FINISH (TABLE 2)

マウント形状 D:位置決めボス・ホルドダウン有
E:位置決めボス・ホルドダウン無

MOUNT: D:WITH POSITIONING BOSS, WITH HOLD-DOWN
E:WITH POSITIONING BOSS, WITHOUT HOLD-DOWN

平座高
STACKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX** (NOTE2)

N:逆戻防止キ係
K:逆戻防止キ有
N:WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY
K:WITH MISMATING PREVENTION KEY

様
NO. OF CONTACTS

14:レセプタクル
15:プラグ
14:RECEPTACLE
15:PLUG

シリーズ
SERIES PREFIX

TABLE 1 DIMENSION

開発状態 DEVELOPMENT CONDITION	芯数 NO. OF CONTACT	A	B	C	D
○	20	7.2	8.7	12.3	16
×	30	11.2	12.7	16.3	20
○	40	15.2	16.7	20.3	24
○	50	19.2	20.7	24.3	28
○	60	23.2	24.7	28.3	32
○	70	27.2	28.7	32.3	36
×	80	31.2	32.7	36.3	40
○	100	39.2	40.7	44.3	48
×	120	47.2	48.7	52.3	56
×	140	55.2	56.7	60.3	64

○: 開発済み X: 開発予定
:DEVELOPED :DEVELOPMENT PROGRAM

NOTE 1. COPLANARITY:0.1mm MAX.

2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX14 (RECEPTACLE)
+ HEIGHT OF KX15 (PLUG)

EX.: KX14-**-K11E, KX15-**-K2E → 13mm=11+2

3. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED. (EXCEPT '**K11D9E')
(EX.) A4X11

LOT NUMBER OF CURRENT MONTH

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIBELY, OCT. :0, NOV. :X, DEC. :Y)

YEAR (LAST DIGIT ONLY)

MANUFACTURER CODE

注1. 端子の平坦度は、0.1以下。

2. KX14 (レセプタクル) の数と、KX15 (プラグ) の数とを加えた値が
平行基板間高さになります。

3. 図示の面に、ロット番号を表示する。(**K11D9Eを除く)

(例) A4X11

月の生産ロット番号

月表示: 1~9 (10月:0, 11月:X, 12月:Y)

年表示 (西暦末尾)

製造コード

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.